

证券代码：301200

证券简称：大族数控

## 深圳市大族数控科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他券商策略会、电话会议
参与单位名称及人员姓名	民生机械（6月12日） 中金公司策略会（6月12日） 易方达基金（6月17日） 兴证全球基金（6月18日） 天风证券（6月18日） 花旗银行（6月18日） 广发证券（6月19日） 宝新投资（6月23日） 华创证券（6月24日） 爱建资管（6月24日） 淳厚基金（6月24日） 粤民投基金（6月24日） 天风证券策略会（6月26日）
时间	2025年6月12日-6月26日
地点	公司会议室、上海
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务总监兼董事会秘书：周小东 证券事务代表：周鸳鸯

投资者关系活动  
主要内容介绍

### 一、公司经营情况

AI 服务器及数通产品需求持续上升，加上智能手机、汽车电子等终端产品的技术升级，共同推动 PCB 行业各类细分产品的成长，特别是高多层板及 HDI 板市场增长迅猛，持续带动 PCB 产业市场规模上升及下游客户资本支出增加，公司 2025 年第一季度实现营业收入 95,984.87 万元，同比增长 27.89%，归属于上市公司股东的净利润 11,677.35 万元，同比增长 83.60%。

### 二、PCB 行业发展趋势

根据行业知名研究机构 PrismaMark 最新分析报告，受益于 AI 产业链基础设施需求爆发的推动，叠加消费电子复苏、汽车电子技术升级等多重利好因素，2024 年全球电子终端产业营收呈现增长趋势；而 2025 年全球 PCB 产业在 AI 产业链推动下将持续成长，增幅预期调高至 7.6%，并对行业的中长期发展趋势维持积极展望，预估 2024-2029 年 PCB 行业营收复合增长率为 5.2%，产量的复合增长率更是高达 6.8%，其中 18 层以上高多层板、IC 封装基板及 HDI 板保持较高增速，未来五年复合增长率分别为 15.7%、7.4%、6.4%，对应的终端产品为 AI 算力服务器、高速通讯设施、AIPC 及 AI 智能手机等，PCB 产业的增长依然以 AI 产业带动为主。

另一方面，受 PCB 产业链 China+N 的加速推进影响，泰国、越南、马来西亚等东南亚国家未来几年扩产项目的产能将持续增加，其 2024-2029 年复合成长率高达 7.1%，高于中国大陆 4.3% 的增长水平，但由于东南亚地区 PCB 产业基数较小，PCB 产业增加值远低于中国大陆，长期来看，中国大陆的市场地位较为稳固。

### 三、公司核心竞争力

公司具有创新的自主研发模式：以细分市场及应用场景为中心，依托细分场景研究平台、各产品研发平台及专业技术研究平台，链接上下游产业链开展研发合作，持续挖掘不同细分场景下的 PCB 制程难点与痛点，突破各细分场景现有工艺瓶颈并满足前瞻需求，并通过各细分场景工艺的自我迭代及提升，持续确保公司产品及解决方案的竞争优势，为下游 PCB 行业客户提供各细分市场（场景）一站式最优加工解决方案。

同时，公司创新业务发展模式，通过布局 PCB 生产关键工序及多品类产品为客户提供一站式解决方案，实现了应用场景、技

术、供应链、设备与材料、产品、工序、客户的多维协同，并创造性地发挥协同优势，放大客户、供应链及产业链伙伴、公司整体价值，不断提升公司产品的技术能力和客户服务能力，助力下游客户提升综合竞争力，更好的满足不断演进的 PCB 先进制造需求。

#### 四、高多层及高多层 HDI 板市场情况

在高多层板市场，随着数据量大幅攀升，AI 服务器、高速交换机等产品纷纷采用更高层数的多层板，下一代 112/224Gbps 高速数据传输对信号完整性的保障提出更高要求，高多层板背钻的精度要求大幅提升，公司开发的新型 CCD 六轴独立机械钻孔机搭载 3D 背钻及钻测一体技术，可实现超短残桩和超高同心度，已获得行业多家高多层板龙头企业的认可及批量订单；同时，针对高多层板高厚径比通孔钻孔、高精度层间对位及高可靠性电性能测试等技术要求，公司提供更多产品组合方案，包含大扭力主轴钻孔设备、超高层间对位精度数字成像系统、大台面六倍密通用测试机及大点数 CCD 四线测试机产品，助力下游客户提升该类高附加值产品的生产良率及品质信赖度。

市场增长最为显著的 AI 服务器用高多层 HDI 板，其产品更加结构复杂，其中导通孔的形式包含埋通孔、通孔、背钻孔、盲孔、跨层盲孔，且都集中在单片 PCB 上，融合了高多层板及高密度板的双重特性。公司是行业内少数可提供对应成套解决方案的企业，并针对该类产品厚度大、重量大的特点优化产品传输及夹持系统，提供机械钻孔机、3D 背钻及钻测一体 CCD 背钻机、CO2 激光钻孔机、UV 激光钻孔机等；同时，该类 PCB 线路一致性要求极高，公司提供高分辨率及高层间对位精度的数字成像系统，获得国内外客户信赖；另外，该类产品结构复杂，增加了质量的不确定性，公司提供超大点数四线测试机，获得全球顶级 AI 服务器 PCB 生产厂商的高度评价。

#### 五、公司的发展战略规划

公司将围绕“成为世界范围内最受尊敬和信赖的 PCB 装备服务商”的战略愿景，充分把握 PCB 产业技术升级及新竞争格局带来的专用设备蓬勃发展的机遇，通过构建国内外产能，深度参与全球竞争，来实现公司业务的永续发展。一方面，公司将持续深挖多层板市场价值，加大创新研发力度，打造超越客户预期的优化解决方案，并通过产业链上下游价值发现机制，不断拓宽公司产品矩

	<p>阵，持续放大公司在该市场的价值；另一方面，公司聚焦市场增速快、技术门槛更高的 HDI 板、IC 封装基板、挠性板及刚挠结合板等领域，发挥多产品、多场景的协同优势，研发适应不同细分市场需求的、具有市场竞争力的覆盖 PCB 生产全流程的智能制造解决方案，不仅要从产品性能层面打破国外的技术垄断，更要从 PCB 全流程智造的维度实现对国外技术的赶超。同时，随着全新人工智能时代的来临，面对新一轮以人工智能为代表的科技发展浪潮，公司将密切关注行业发展变化，加大研发创新与市场开拓力度，抓住新一轮行业增长的重大机遇。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 6 月 30 日